(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年10月2日(02.10.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/204647 A1

(51) 国際特許分類:
B23Q 3/18 (2006.01) *B24B 7/17* (2006.01)
B23Q 3/02 (2006.01) *B24B 41/06* (2012.01)
B23Q 7/04 (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2025/008044

(22) 国際出願日： 2025年3月5日(05.03.2025)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2024-057253 2024年3月29日(29.03.2024) JP

(71) 出願人: 株式会社レゾナック・ハードディスク(**RESONAC HARD DISK CORP.**) [JP/JP]; 〒2900067 千葉県市原市八幡海岸通５番地１ (JP).

(72) 発明者: 久志野 高宏 (**KUSHINO, Takahiro**); 〒3238678 栃木県小山市犬塚１丁目４８０番地 株式会社レゾナック・ハードディスク内 (JP). 間舘 秀雄(**MADATE, Hideo**); 〒3238678 栃木県小山市犬塚１丁目４８０番地 株式会社レゾナック・ハードディスク内 (JP).

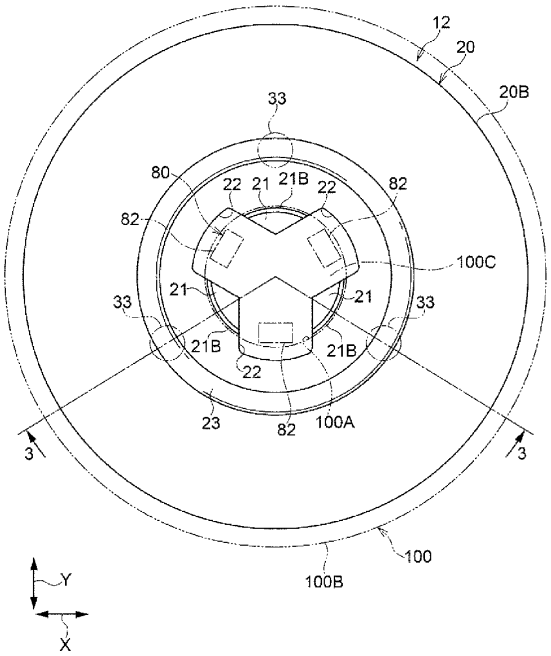
(74) 代理人: 弁理士法人太陽国際特許事務所(**TAIYO, NAKAJIMA & KATO**); 〒1600022 東京都新宿区新宿４丁目３番１７号 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

WO 2025/204647 A1

(54) **Title:** POSITIONING METHOD, METHOD FOR MANUFACTURING DISK-SHAPED SUBSTRATE, POSITIONING DEVICE, AND DEVICE FOR MANUFACTURING DISK-SHAPED SUBSTRATE

(54) 発明の名称： 位置決め方法、円盤状基板の製造方法、位置決め装置、及び円盤状基板の製造装置



(57) **Abstract:** In this positioning method: a disk-shaped substrate having an inner periphery and a hole surrounded by the inner periphery is placed on a table; a contact part inserted into the hole from the table side is brought into contact with the inner periphery; and the disk-shaped substrate is positioned in a direction along the radial direction of the disk-shaped substrate before being transported to a predetermined position on a table of a processing apparatus.

(57) 要約：位置決め方法は、内周と当該内周に囲まれた孔とを有する円盤状基板を台に載せ、当該台側から前記孔に挿入された接触部を前記内周に接触させて、当該円盤状基板を、加工装置の台上の予め定められた位置へ搬送する前に当該円盤状基板の径方向に沿った方向に位置決めする。

［続葉有］

(84) 指定国（表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能）：ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一　国際調査報告（条約第21条(3)）